

Добро пожаловать в O-ведущий

Мы являемся профессиональным производителем печатных плат с более чем десятилетним опытом. Ассортимент продукции - односторонняя, двухсторонняя, многослойная печатная плата, гибкая печатная плата и МСРСВ. Мы можем обеспечить быстрое обслуживание прототипа - S / S за 24 часа, 4-8 слоев за 48-96 рабочих часов.

Отверстия для медных пластин минимальные .025 AVG, мин .020. Отверстия не могут быть вставлены

Упакуйте бесцветную прозрачную пузырьковую пленку, 25 шт. / Пакет, положите осушитель на бок, положите карточку индикатора влажности на верхнюю сторону

Описание товара

Быстрые Детали

Место происхождения:	Guangdong Кита (материк)	Название бренда:	O-Leading
Базовый материал:	FR-4, алюминий	Медная толщина:	0.5oz-5oz
Минимум Размер отверстия:	0.2mm	Минимум Ширина линии:	0.2mm
Поверхностная обработка:	золото погружения, OSP, бессвинцовый HASL	Толщина доски	0.1-5mm
применимый к:	светодиод, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины	персонаж:	Промышленный контроль печатной платы
сертификаты:	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN:	10шт-100шт
вес:	0,01 кг -5 кг	MOQ:	10 шт
цвет	синий, красный, зеленый, черный. желтый	цена	\$ 0.1- \$ 10
Номер модели	Power Bank PCB Ассамблеи РСВА производитель	размер	0.01m3-10m3
тип design	требование клиента	Минимум Межстрочный интервал	0.2mm

Упаковка и Доставка

Детали упаковки:	16 лет профессиональный производитель печатных плат OEM
Деталь доставки:	7-12days

Описание товара

16 лет профессионального изготовления печатных плат OEM

вещь	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	объем	Образец	объем	Образец	объем	Образец
Количество слоев	32	42	38	44	42	48
Минимальная линия / пространство (мкм)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Мин сверлить диаметр (мм)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Соотношение сторон из ПТГ	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N,	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любое соединение слоев	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Заполнение пластины через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Минимум толщина сердечника (исключая медь) (мкм)	50	40	40	30	40	30
Минимум Диаметр лазерной дрели (мкм)	75	65	65	50	50	40
Виа на похоронен отверстие / сложено через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper и др.					
Встроенная конденсаторная плата	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Поверхностный процесс	Бессвинцовые HASL, ENIG, OSP, Иммерсионное серебро, Иммерсионное олово, Вспышка золота, покрытие золотым пальцем, селективное покрытие из твердого золота, Отрывная паяльная маска, Углеродные чернила					



www.o-leading.com

[Плата с печатным монтажом pcb HDI, быстрая плата с печатным монтажом pcb поворота](#)

Наша команда





Сертификаты



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component



ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [online family of databases](#).
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED E490354

Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Type	Cond Width			SS/ DS/ Diam	Area	Solder		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Temp			
Hub/Bayer (mass laminate) printed wiring boards.										
D-LEADING-401										
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-
D-LEADING-407										
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI
Hub/Bayer printed wiring boards.										
D-LEADING-408										
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) min:1.35	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI
Single layer printed wiring boards.										
D-LEADING-002										
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI
D-LEADING-003										
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲
D-LEADING-033										
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI
D-LEADING-205										
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI
D-LEADING-206										
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

http://www.ul.com/onlinecertifications/201VZL430354/Wiring,Printed-Component



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SNI1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "r" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new online certification platform, which provides a secure and efficient way to manage your certification data. The platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, allowing you to view your certification status at any time. For more information, please contact your account manager or visit our website at www.sgscertification.com.

Member of the SGS Group (SGS SA)

Упаковка и Доставка

Упаковка	16 лет профессиональный производитель печатных плат OEM
Деталь доставки	7-12days



Часто задаваемые вопросы

1. Как O-Leading обеспечивает качество?

Наш высокий стандарт качества достигается с помощью следующего.

1. Процесс строго контролируется в соответствии со стандартами ISO 9001: 2008.
2. Широкое использование программного обеспечения в управлении производственным процессом
3. Современное испытательное оборудование и инструменты. Например. Летящий зонд, рентгеновский контроль, AOI (автоматический оптический инспектор) и ИКТ (внутрисхемное тестирование).
4. Специальная команда обеспечения качества с процессом анализа случаев отказа
5. Непрерывное обучение и воспитание персонала

2. Как O-Leading поддерживает вашу цену конкурентоспособной?

За последнее десятилетие цены на многие виды сырья (например, медь, химикаты) увеличились в два, три или четыре раза; Китайская валюта укрепилась на 31% по отношению к доллару США; И наша рабочая сила также значительно увеличилась. Тем не менее, O-Leading сохранили наши цены стабильными. Это полностью относится к нашим инновациям в снижении затрат, предотвращении отходов и повышении эффективности. Наши цены очень конкурентоспособны в отрасли на том же уровне качества.

Мы верим в беспроигрышное партнерство с нашими клиентами. Наше партнерство будет

взаимовыгодным, если мы сможем предоставить вам преимущество по стоимости и качеству.

3. Какие доски могут обрабатывать O-Leading?

Обычные FR4, высокотемпературные и безгалогеновые плиты, Rogers, Arlon, Telfon, плиты на основе алюминия / меди, PI и т. Д.

4. Какие данные необходимы для производства печатных плат?

Лучше всего предоставлять данные в формате Gerber 274-X. Кроме того, Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP и Eagle также могут быть обработаны.

5. Каков типичный технологический процесс для многослойной печатной платы?

Резка материала → Внутренняя сухая пленка → Внутреннее травление → Внутренний AOI → Многослойное соединение → Укладка слоев Прессование → Сверление → PTH → Покрытие панели → Наружная сухая пленка → Покрытие рисунка → Внешнее травление → Внешний AOI → Маска припоя → Марка компонента → Поверхность → Маршрутизация → E / T → Визуальный осмотр.